

## 臻鼎召開 2026 股東常會

### AI 應用全面帶動 PCB 結構升級 新一輪高速成長周期啟動 目標未來五年加速成長

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號：4958)今(29)日召開 2026 年股東常會。臻鼎董事長沈慶芳於會中表示，人工智慧 (AI) 快速發展，正為電子產業帶來結構性變革，也為 PCB 產業創造千載難逢的成長契機。根據研調機構 Prismark 統計，2026 年全球 PCB 產值預計將年增 12.5%至 956 億美元，2025 年至 2030 年的年均複合成長率可望達 7.7%，市場規模將突破 1,230 億美元。受惠於 AI 相關應用需求持續擴張，臻鼎 2025 年合併營收再創歷史新高；憑藉公司在高階產品、關鍵製程與全球產能布局上的長期耕耘，臻鼎目標未來五年營收成長優於產業平均水準，並將同步提升獲利表現，為股東創造長期價值。

董事長沈慶芳指出，AI 發展正推動 PCB 角色由傳統訊號連接，進一步升級為高效能運算與系統整合的重要載體。面對此一趨勢，臻鼎已建立橫跨「雲、管、端」的全方位產品與製程能力，並將於 2026 年迎來「雲」與「管」兩大應用領域的高速成長。在 AI 伺服器方面，GPU 與 ASIC 客戶之 Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品將陸續轉入量產；在光模塊方面，客戶新一代產品朝 1.6T 升級，進一步推升採用 MSAP 技術之高階 PCB 需求；在 IC 載板方面，AI 算力需求快速擴張，亦將帶動高階 ABF 載板成長動能持續放大。臻鼎預期，2026 年伺服器/光模塊業務營收將成倍增長，IC 載板營收亦目標成長 70%以上，顯示公司營運結構正加速朝高階 AI 應用升級，並將成為未來數年推動營收規模擴大與獲利能力提升的關鍵引擎。

面對 AI 浪潮與全球供應鏈重組並行的新時代，沈董事長強調，臻鼎正積極擴大全球高階產能與技術領先優勢，掌握 AI 驅動下 PCB 產業的新一輪結構性成長機會。臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充階段，這不僅是為了滿足客戶訂單成長，更是為了建構高度韌性、具備區域彈性與高階製程能力的全球生產體系。其中，淮安科技城 HD 園區已於今年 4 月正式動土，將新建 HDI/MSAP 與 HLC 廠，完工後淮安科技城四座園區總廠房數將達 23 座，目標打造全球規模最大、技術最先進的 PCB 生產基地。泰國廠區將成為服務全球客戶及強化供應鏈韌性的關鍵基地，一廠量產爬坡順利，二廠規劃於 2027 年進入量產，三廠、五廠及機械鑽孔中心亦同步建置中；高雄 AI 園區則聚焦高階 ABF 載板與高階 PCB 產能，定位為先進製程與高階產品的重要據點。隨著淮安、泰國與高雄等高階產能陸續到位，臻鼎將進一步強化全球供應彈性與客戶服務能力，支撐未來營運規模與產品組合持續升級。

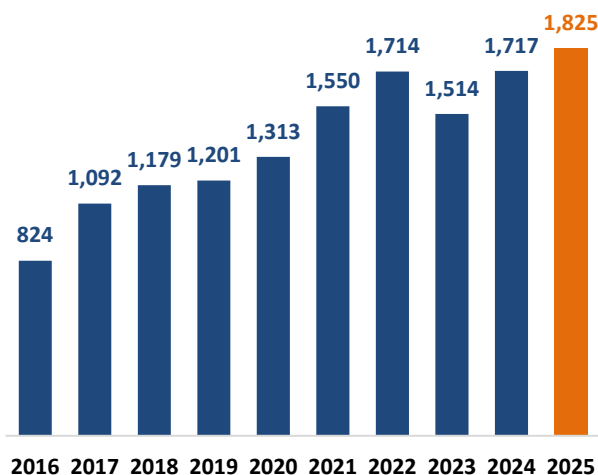
沈董事長進一步表示，「One ZDT」是臻鼎面對科技產業快速迭代與 AI 應用加速擴張的核心策略。透過業界難以複製的「一站式購足平台」，臻鼎可為全球客戶提供跨產品、跨區域、跨技術的整合解決方案，並持續強化在軟板、硬板、HDI 與 IC 載板四大產品線的研發與製造能力。2025 年，臻鼎專利獲證數量正式超過 2,000 件，展現公司在技術研發與製程創新上的長期累積。未來，隨 AI 伺服器、光模塊、IC 載板及應用於折疊手機、智慧眼鏡等邊緣 AI 裝置之高階軟板與類載板需求持續成長，臻鼎將進一步深化與國際關鍵客戶的協同合作，推動產品組合朝高附加價值應用升級，並持續提升營收品質與獲利能力。

除營運成長外，臻鼎亦持續深化永續發展與公司治理，並在國際第三方永續評鑑中屢獲肯定。2026 年，臻鼎首次入選「道瓊領先世界指數（Dow Jones Best-in-Class World Index）」及「道瓊領先新興市場指數（Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index）」成分股，成為台灣 PCB 企業中唯一同時入選兩項指數的公司。另在 CDP 評鑑中，臻鼎 2025 年於氣候變遷與水安全管理雙雙獲得最高等級「A」評級，其中氣候變遷為首度獲得 A 級，水安全則已連續兩年獲得 A 級；同時入選《商業周刊》「2025 碳競爭力百強企業」，展現公司在永續治理、環境管理與企業責任上的長期投入與具體成果。

展望未來，沈董事長表示，AI 應用正從雲端算力、高速傳輸延伸至各式智慧終端，將持續推升高階 PCB 與 IC 載板需求。臻鼎將持續以「One ZDT」為核心，結合完整產品組合、全球化產能布局、關鍵製程技術與智慧製造能力，掌握 AI 伺服器、光模塊、IC 載板及邊緣 AI 應用等高成長機會。隨著高階產品比重提升與新產能逐步開出，臻鼎有信心進一步擴大營收規模、優化產品組合並提升獲利能力，持續鞏固全球 PCB 領導地位，為客戶、員工、股東及社會創造長期且穩健的價值。

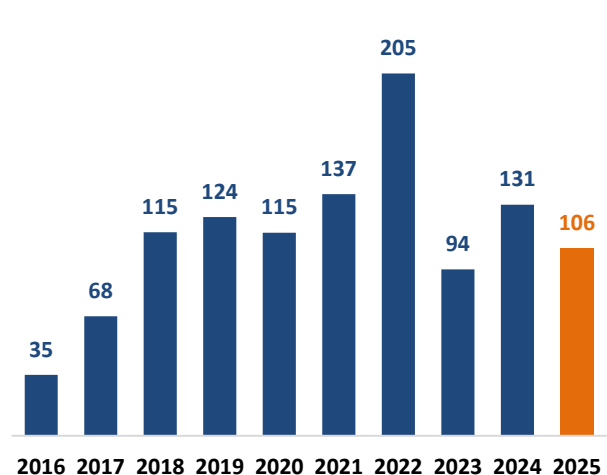
**臻鼎歷年營業收入**

單位：新台幣億元



**臻鼎歷年稅後淨利**

單位：新台幣億元



## 關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球

PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2025 年連續九年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: [www.zdtco.com](http://www.zdtco.com)。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: [duen.t.ling@zdtco.com](mailto:duen.t.ling@zdtco.com)